

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2012-002

## 南通富士通微电子股份有限公司 2011 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本公告所载 2011 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

### 一、2011 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,622,046,684.09	1,727,112,896.76	-6.08%
营业利润	11,829,124.67	112,276,500.68	-89.46%
利润总额	61,191,746.25	157,387,940.59	-61.12%
归属于上市公司股东的净利润	49,028,221.73	139,078,880.99	-64.75%
基本每股收益（元）	0.08	0.25	-68.00%
加权平均净资产收益率	2.27%	11.69%	-9.42%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	3,390,223,114.94	3,634,209,945.48	-6.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,180,581,960.23	2,132,306,971.55	2.26%
股本	649,866,720.00	406,166,700.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.36	5.25	-36.00%

### 二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 半导体行业在经历了 2010 年强劲增长态势之后，2011 年，日本地震、欧债危机、泰国水灾导致全球市场萧条、半导体行业需求下滑；同时，智能产品的迅速突起，导致传统产品竞争加剧，使得我们未能像 2010 年那样，再次实现高速增长。面对复杂的外部环境给生产经营带来的诸多困难，公司采取切实措施，稳中求进，加快技术创新及量产步伐，开发了降低 BGA 封装成本的新技术，BGA 月产量一举突破 600 万块。同时，铜线工艺取得突破性进展，铜线产品占比达到 25% 以上，为公司降本工作做出贡献。2011 年公司建成了 WLCSP 封装生产线并生产出具有质量优势的产品，WLCSP 产品今后有望成为新的增长点。这一年，公司努力克服了半导体市场增速趋缓、竞争激烈等不利因素的影响，实现了产量、销售收入的同比略有下降。但由于原材料上涨、人工成本增加、人民币升值等因素的影响，导致利润下降明显。

2011 年度，公司完成营业总收入 1,622,046,684.09 元，较 2010 年度减少 6.08%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较 2010 年同期分别下降 89.46%、61.12%、64.75%、68.00%。

2. 2011 年末，公司股本较期初增加 60.00%，是由于公司于 2011 年内实施了权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 6 股，由此成为归属于上市公司股东的每股净资产下降 36.00% 的主要原因。

### 三、与前次业绩预计的差异说明

无差异

### 四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

无

六、备查文件

- 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
- 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

南通富士通微电子股份有限公司董事会  
2012年2月28日